

# 有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成24年4月1日  
(第8期) 至 平成25年3月31日

## 株式会社テラプローブ

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号

(E24994)

# 目次

頁

表紙

第一部 企業情報 .....	1
第1 企業の概況 .....	1
1. 主要な経営指標等の推移 .....	1
2. 沿革 .....	3
3. 事業の内容 .....	4
4. 関係会社の状況 .....	7
5. 従業員の状況 .....	7
第2 事業の状況 .....	8
1. 業績等の概要 .....	8
2. 生産、受注及び販売の状況 .....	10
3. 対処すべき課題 .....	10
4. 事業等のリスク .....	11
5. 経営上の重要な契約等 .....	14
6. 研究開発活動 .....	15
7. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 .....	16
第3 設備の状況 .....	19
1. 設備投資等の概要 .....	19
2. 主要な設備の状況 .....	19
3. 設備の新設、除却等の計画 .....	20
第4 提出会社の状況 .....	21
1. 株式等の状況 .....	21
2. 自己株式の取得等の状況 .....	30
3. 配当政策 .....	31
4. 株価の推移 .....	31
5. 役員の状況 .....	32
6. コーポレート・ガバナンスの状況等 .....	35
第5 経理の状況 .....	40
1. 連結財務諸表等 .....	41
(1) 連結財務諸表 .....	41
(2) その他 .....	75
2. 財務諸表等 .....	76
(1) 財務諸表 .....	76
(2) 主な資産及び負債の内容 .....	90
(3) その他 .....	92
第6 提出会社の株式事務の概要 .....	93
第7 提出会社の参考情報 .....	94
1. 提出会社の親会社等の情報 .....	94
2. その他の参考情報 .....	94
第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....	95

[監査報告書]

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月26日
【事業年度】	第8期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
【会社名】	株式会社テラプローブ
【英訳名】	Tera Probe, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 雄一郎
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
【電話番号】	045（476）5711
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO 神戸 一仁
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
【電話番号】	045（476）5711
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO 神戸 一仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

回次	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
売上高 (千円)	18,624,790	17,836,950	21,381,338	24,190,114	21,306,278
経常利益又は 経常損失 (△) (千円)	△4,232,948	2,585,384	4,835,290	2,401,711	101,234
当期純利益又は 当期純損失 (△) (千円)	△5,903,792	2,231,284	4,151,465	△5,530,269	500,067
包括利益 (千円)	—	—	4,449,979	△5,359,646	1,078,679
純資産額 (千円)	15,169,253	17,661,055	26,557,660	21,198,013	22,237,605
総資産額 (千円)	36,942,508	32,739,840	50,325,335	41,088,795	35,542,576
1株当たり純資産額 (円)	18,338.04	21,278.86	2,681.80	2,084.22	2,165.57
1株当たり当期純利益金額 又は1株当たり当期純損失 金額 (△) (円)	△7,687.23	2,905.32	509.44	△595.77	53.87
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	38.1	49.9	49.5	47.1	56.6
自己資本利益率 (%)	—	14.7	20.1	—	2.5
株価収益率 (倍)	—	—	4.60	—	18.19
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	8,796,061	9,327,151	10,382,013	9,813,515	7,543,539
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	△4,628,545	△807,796	△8,503,314	△10,671,740	△2,896,902
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	△8,212,785	△7,469,502	2,532,815	△804,376	△4,260,312
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	1,761,676	2,820,690	7,211,189	5,557,662	6,043,022
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	301 (338)	311 (170)	390 (80)	660 (160)	670 (131)

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 自己資本利益率については、当期純損失の場合は記載しておりません。

4. 株価収益率については、当社株式は第5期までは非上場であるため、記載しておりません。また、第7期は、当期純損失であるため記載しておりません。

5. 第4期以降の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

6. 第4期は、米国のサブプライムローン問題を背景とした金融市場の混乱などにより消費が大きく落ち込み、当社のテスト受託にも大きな影響が生じた結果、売上高、損益とも大きく落ち込みました。

7. 第5期より固定資産の耐用年数を変更したことにより経常利益、当期純利益等の金額に影響が出ており、変更前の方法によった場合に比べて、同期の経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ3,553,055千円、3,455,219千円増加しております。

8. 第7期は、特別損失として貸倒引当金繰入額及び減損損失等を計上した結果、当期純損失となりました。

9. 第8期より、連結子会社1社において、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更したため、第7期については、当該会計方針の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。

10. 当社は、平成22年5月28日付で株式1株につき10株の株式分割を行っております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次		第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
決算年月		平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
売上高	(千円)	17,900,293	15,835,180	18,144,772	19,080,956	15,213,920
経常利益又は 経常損失(△)	(千円)	△4,404,803	2,082,836	3,874,890	2,297,153	928,544
当期純利益又は 当期純損失(△)	(千円)	△5,966,035	2,063,524	3,801,136	△6,091,080	1,114,130
資本金	(千円)	9,600,000	9,600,000	11,823,312	11,823,312	11,823,312
発行済 株式総数						
	普通株式(株)	740,000	768,000	9,282,500	9,282,500	9,282,500
	A種類株式(株)	508,000	—	—	—	—
純資産額	(千円)	14,284,080	16,347,605	24,595,366	18,504,285	19,618,391
総資産額	(千円)	35,962,438	30,970,566	45,399,955	33,395,094	28,775,273
1株当たり純資産額	(円)	18,599.06	21,285.94	2,649.65	1,993.46	2,113.49
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)	(円)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
1株当たり当期純利益金額 又は1株当たり当期純損失 金額(△)	(円)	△7,768.28	2,686.88	466.45	△656.19	120.03
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	(円)	—	—	—	—	—
自己資本比率	(%)	39.7	52.8	54.2	55.4	68.2
自己資本利益率	(%)	—	13.5	18.6	—	5.8
株価収益率	(倍)	—	—	5.03	—	8.17
配当性向	(%)	—	—	—	—	—
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)	(人)	253(338)	227(170)	283(80)	294(123)	317(102)

- (注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 自己資本利益率については、当期純損失の場合は記載しておりません。
4. 株価収益率については、当社株式は第5期までは非上場であるため、記載しておりません。また、第7期は、当期純損失であるため記載しておりません。
5. A種類株式は無議決権株式であり、交付請求に応じてA種類株式との引換えにより交付される普通株式の数は、取得されるA種類株式の数に、A種類株式1株の払込金相当額50,000円(A種類株式につき株式分割、株式併合その他一定の事由が生じた場合はそれぞれにつき適宜調整されます。)をその時点における交換価額(払込金相当額。ただし、当該価額より低い発行価額による当社普通株式の新株発行その他一定の事由により下方調整されます。)で除した数を乗じて算出されます。なお、当社は平成17年9月29日付の第三者割当増資により94,000株、平成19年3月31日付で吸収分割に伴い160,000株のA種類株式を発行していましたが、平成22年3月31日付で全数(平成20年2月15日付株式分割により508,000株)消却しております。
6. 第4期は、米国のサブプライムローン問題を背景とした金融市場の混乱などにより消費が大きく落ち込み、当社のテスト受託にも大きな影響が生じた結果、売上高、損益とも大きく落ち込みました。
7. 第5期より固定資産の耐用年数を変更したことにより経常利益、当期純利益等の金額に影響が出ており、変更前の方法によった場合に比べて、同期の経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ3,553,055千円、3,455,219千円増加しております。
8. 第7期は、特別損失として貸倒引当金繰入額及び減損損失等を計上した結果、当期純損失となりました。
9. 第3期及び第4期の1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額はA種類株式の期中平均株式数を含めた、768,000株として計算しております。
10. 第4期から第5期にかけて従業員数が減少しているのは、他社への一時的な出向者を差し引いているためです。
11. 第4期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
12. 当社は、平成20年2月15日付で株式1株につき2株の株式分割を、また、平成22年5月28日付で株式1株につき10株の株式分割を行っております。

## 2 【沿革】

年月	事項
平成17年 8月	東京都中央区に当社設立。資本金1,000万円。
平成17年 9月	エルピーダメモリ株式会社、Kingston Technology Japan, LLC、Powertech Technology Inc. 及び株式会社アドバンテストを割当先とする第三者割当増資を実施。新資本金56億円。 産業活力再生特別措置法(注1)に基づく「経営資源再活用計画」の認定取得。
平成17年10月	広島事業所（広島県東広島市）にてDRAM(注2)のウエハテスト事業(現メモリ事業)(注3)を開始。 開発センター（神奈川県相模原市中央区）にてテスト技術等の開発受託事業(現メモリ事業)を開始。
平成18年 5月	広島事業所にてエルピーダメモリ株式会社以外のウエハテスト事業(現メモリ事業)を開始。
平成18年 6月	広島事業所にてISO9001（品質マネジメントシステム）の認証取得。 熊本県葦北郡芦北町に九州事業所用地及び建物取得。
平成18年 9月	九州事業所を開設。ロジック製品のファイナルテスト事業(現システムLSI事業)(注3)を開始。
平成18年11月	九州事業所にてロジック製品のウエハテスト事業(現システムLSI事業)を開始。
平成19年 1月	九州事業所にてISO9001（品質マネジメントシステム）の認証取得。
平成19年 3月	神奈川県横浜市港北区に本社・開発センターを移転。 産業活力再生特別措置法の上記認定の取消し(注4)、及び同法に基づく「事業再構築計画」の認定取得。 吸収分割により広島エルピーダメモリ株式会社（現：エルピーダメモリ株式会社）からウエハテスト事業(現メモリ事業)に関する設備・装置等を承継。新資本金96億円。
平成19年 4月	DRAM以外の半導体受託拡大を目指し、九州事業所にB棟竣工。
平成19年 9月	九州事業所B棟操業開始。
平成19年12月	ISO14001（環境マネジメントシステム）の認証取得。 ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証取得。
平成20年 8月	台湾新竹縣に台湾における事業拡大を目的として、Powertech Technology Inc. と合併で連結子会社 TeraPower Technology Inc. を設立。
平成21年 3月	エルピーダメモリ株式会社の連結子会社となる。
平成21年 7月	九州事業所内にデバイス開発・評価サービスを提供する目的でテストセンターを開設。
平成22年 2月	事業部制を導入。メモリ事業部、システムLSI事業部を設置。
平成22年12月	東京証券取引所マザーズに株式を上場。 エルピーダメモリ株式会社の持株比率低下により持分法適用会社となる。
平成23年10月	カシオ計算機株式会社より株式会社テラミクロスの全株式を取得、連結子会社として、ウエハレベルパッケージ(WLP)の受託を開始。
平成24年 3月	OHS581214(労働安全衛生マネジメントシステム)の認証取得。

(注) 1. 産業活力再生特別措置法：日本における経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編及び経営資源再活用を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講じるとともに中小企業の活力の再生を支援するための措置を講じ、併せて事業者の経営資源の増大に資する研究活動の活性化等を図ることにより、日本産業の活力の再生を速やかに実現することを目的として平成11年に制定された法律です。

2. 「3 事業の内容 用語解説」をご参照ください。

3. 「3 事業の内容」をご参照ください。

4. 広島エルピーダメモリ株式会社からのウエハテスト承継の形態を、当初計画の営業譲渡から、吸収分割に変更したことに合わせた形で改めて認定を取得するため、平成17年9月に取得した認定の取り消しを受ける手続をとったものです。

### 3【事業の内容】

当社グループは、当社（株式会社テラプローブ）、国内連結子会社（株式会社テラミクロス、以下「テラミクロス」といいます。）及び海外連結子会社（TeraPower Technology Inc. 以下、「テラパワー」といいます。）により構成されており、半導体製造工程におけるウエハテスト及びファイナルテスト受託とウエハレベルパッケージ（以下、「WLP」といいます。）受託を主たる業務としております。

一般的に半導体製造工程は、ウエハ(\*1)上に半導体チップを作り込む前工程(\*2)と、半導体チップを組立しパッケージングする後工程(\*3)に分類されます。この前工程で行う検査をウエハテストといい、後工程で行う検査をファイナルテストといいます。当社グループでは、どちらのテスト工程も受託しております。

ウエハテストとは、ダイシング(\*4)前のウエハ状態で、ウエハ上に作り込まれた半導体チップの電気特性を検査し、良品・不良品の判別を行うものです。具体的には、回路が作り込まれたウエハ上の半導体チップにあるパッド(\*5)の一つ一つに、プローブと呼ばれる細い探針を当てて電気信号を流し、半導体回路が設計どおりに機能しているかをテスト(\*6)、プローバ(\*7)等の装置を用いて電氣的に検査します。

さらに当社は、当社の蓄積したノウハウを利用したプログラムの改良を提案し、顧客から支給されたテストプログラムを基に多数個同時測定用プログラムを開発したり、プローブカード(\*8)設計を受託することなどによって、一回のテストでより多くの半導体チップを検査できるようにし、テスト効率を上げることで、顧客のウエハテストのコスト低減に貢献しております。

また、ファイナルテストとは、組立終了後のパッケージ状態で設計どおりに機能するかどうかの検査のほか、最終製品の外観異常の有無を検査するパッケージ外観検査などを含みます。

WLPは、半導体パッケージングの中でもパッケージング後のサイズが小さく、薄いことが特徴のパッケージで、ウエハ状態で加工することで、多数のチップを一括して加工できるという特徴があります。この特長を生かして、スマートフォンなどのモバイル機器で多く採用されています。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

#### (1) メモリ事業

当社グループのメモリ事業の主な業務はDRAM(\*9)のウエハテスト業務の受託であり、主に広島事業所とテラパワーで行っております。当社グループは、当社を持分法関係会社とするエルピーダメモリ株式会社のような日本国内の半導体メーカーや、海外の半導体メーカー、ファブレス等からウエハテストを受託しております。

一般的にウエハテストは、上記のように顧客から支給されたテストプログラムを使用し、ウエハ上に作り込まれた半導体チップの電気特性をテストし、良品・不良品の判別を行い、その結果を顧客に提供して業務が完了します。これに対し、メモリ事業の売上の多くを占めるDRAMでは、ウエハ1枚からより多くの半導体チップを製品化できるように、半導体チップにレーザーを用いた加工を施し、顧客の製造した半導体チップの歩留確保、向上を行っております。

#### (2) システムLSI事業

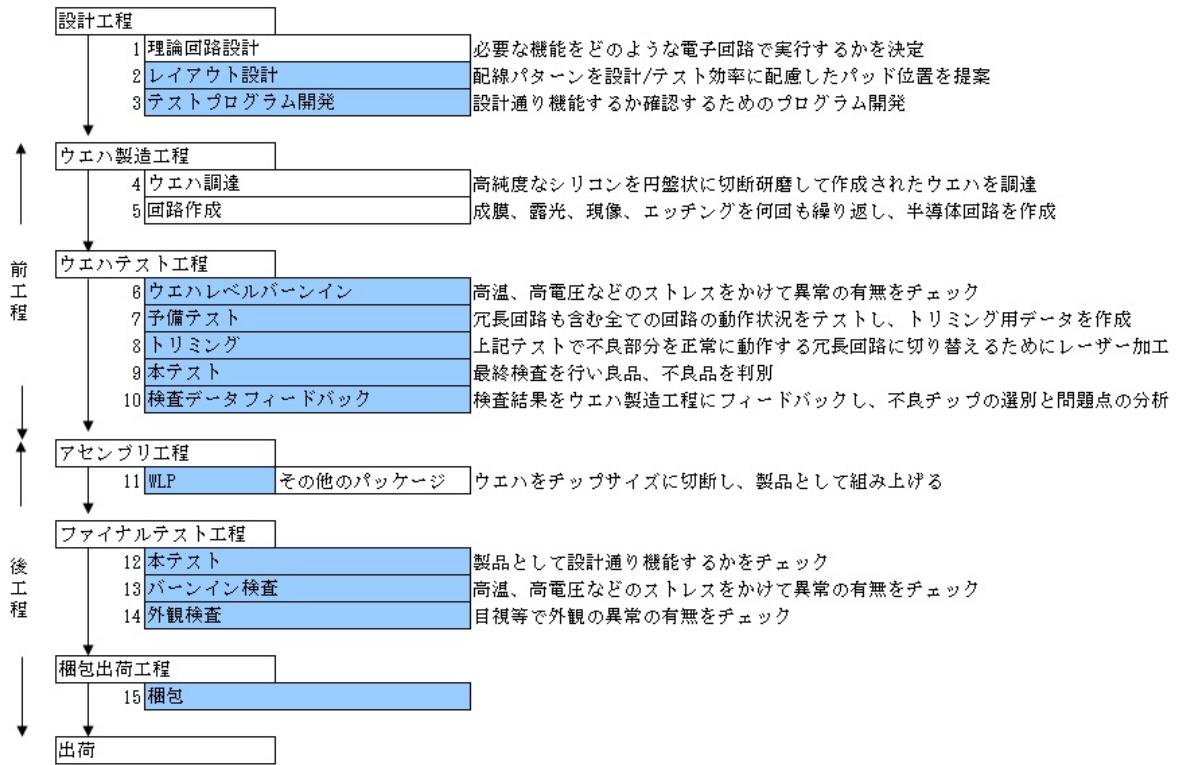
システムLSI事業は、当社では、国内外の半導体メーカーやファブダリが生産したSoC(\*10)、イメージセンサ(\*11)、アナログ(\*12)などの半導体製品のウエハテスト業務の受託が中心で、その他にファイナルテスト業務も受託しており、主に九州事業所で行っております。また、テラパワーにおいてもSoCのテスト業務を受託しており、今後はイメージセンサの受託も見込んでおります。テラパワーでは、自動車産業向け品質マネジメントシステム(ISO/TS16949)の認証を取得し、今後日本と台湾の両拠点で高品質が要求される車載半導体のテスト受託を強化してまいります。

さらに、テラミクロスでは、MEMS(\*13)センサやアナログなど、モバイル機器向けを中心にWLPを受託しております。

システムLSI事業におけるウエハテストも、一般的には顧客から支給されたテストプログラムを使用し、ウエハ上に作り込まれた半導体チップの特性について、良品・不良品の判別を行い、その結果を顧客に提供して業務が完了します。システムLSI事業における受託製品はメモリ事業と比較すると多品種少量生産の場合が多く、製品によりテスト機器やテスト環境が異なるなどの特徴があります。そのため顧客の様々なニーズに対応していく技術力と柔軟性が求められております。

テラミクロスで受託しているWLPは、ウエハ状態で全てのパッケージング工程を完了するため、従来のパッケージに比べ高い生産性を誇り、製品サイズが薄く、小さいという特徴があります。

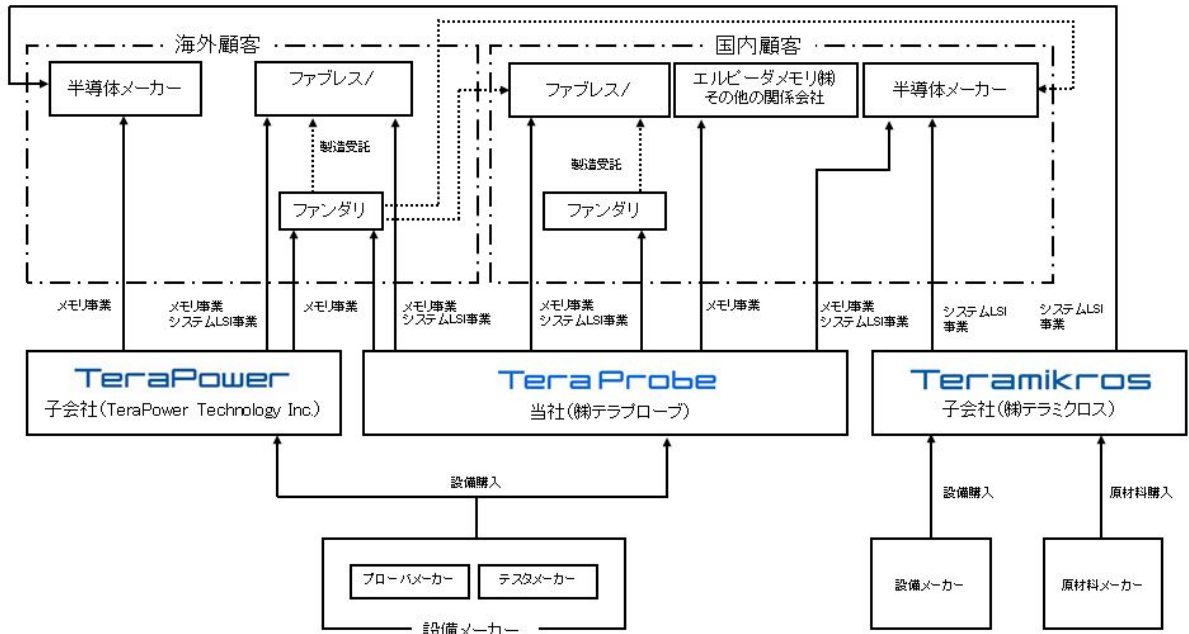
(半導体製造工程)



(注) 上記工程図内のウェハテスト工程(6~10)は、メモリ製品のウェハテスト工程を記載しております。

以上に述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりです。

[事業系統図]





## 用語解説

- (\*1) ウェハ：ウェハは単結晶シリコンの塊（インゴット）から薄く切り出された円盤状のものの表面を研磨した薄い板で、半導体チップを製造するための直接材料となるものです。このウェハ上にトランジスタ、キャパシタ（電荷を蓄える部品：コンデンサ）、配線などを作り込み、電子回路を形成します。  
直径は200mm（8インチ）、300mm（12インチ）が一般的で、大口径化するにつれウェハ1枚当たりから取れる半導体チップ数が多くなりコストダウンにつながります。半導体チップ面積が同じであれば、300mmウェハは200mmウェハの2倍程度のチップの生産が可能です。
- (\*2) 前工程：一般的に半導体製造工程のうち、ウェハ上に半導体チップを作り込み、ウェハ状態で検査し、良品・不良品の判別をするまでの工程を指します。
- (\*3) 後工程：一般的に半導体製造工程のうち、前工程以降の半導体チップをパッケージングし、個々の半導体デバイスを検査し、不良品を除去するまでの工程を指します。
- (\*4) ダイシング：ウェハ上に作られた半導体チップを、ダイヤモンド刃のカッターなどで個々の半導体チップに切り離すことを指します。
- (\*5) パッド：半導体チップ上に形成された端子（電極）を指します。この端子に探針（プローブ）を当て、半導体の電気特性を測定します。
- (\*6) テスタ：半導体の電気特性を検査するための装置です。テストプログラムに基づき、直流、交流特性並びに機能について検査を行います。
- (\*7) プローバ：ウェハの半導体チップ上のパッドにプローブを当てるための装置です。テスタに接続して使用します。
- (\*8) プローブカード：ウェハテストでは、半導体チップ上の端子（電極）にプローブと呼ばれる探針を正確に当てることが求められます。このプローブを素早く正確に半導体チップに当てるために、半導体チップ上の端子パターンに合わせてプローブを配置し、セットにしてテストを行いやすくしたものを指します。  
カードの形状の多くは円形で、カードの周辺部にはテスト装置との接続端子、中央に半導体チップに接続するプローブが取り付けられており、プローバというテスト装置に取り付けて使用します。
- (\*9) DRAM (Dynamic Random Access Memory)：DRAMは、記憶単位が1個のトランジスタと1個のキャパシタ（電荷を蓄える部品：コンデンサ）で構成される半導体で、集積度に優れています。このためビット単価も安く、大容量のメモリを必要とするシステムを中心に使用されます。DRAMは情報をキャパシタに電荷で蓄えるため、微少の漏れ電流によって長時間放置すると情報が失われます。このため定期的に同一情報を再書き込みする必要があります。
- (\*10) SoC (System on Chip)：一つの半導体チップ上に、必要とされる一連の機能（システム）を集積したものを指します。複数の機能を1チップ上に集積することで、基板上に複数の単機能LSIを実装するよりも機器自体の小型化が可能になるなどのメリットがあります。
- (\*11) イメージセンサ：画像を電気信号に変換する半導体素子を指します。デジタルカメラをはじめ、携帯電話などにも広く使用されています。CCD、CMOSなど構造によりいくつかの種類があります。
- (\*12) アナログ：無線通信用半導体や電源制御用半導体、アナログデータをデジタルデータに変換するコンバータなど多くの種類があります。
- (\*13) MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)：機械要素部品（稼動する部品）、センサ、電子回路などを一つの基板上に集積化したデバイスを指します。製品として市販されている物としては、インクジェットプリンタのヘッド、圧力センサ、加速度センサ、DMD（プロジェクタ）、電子コンパスなどがあります。

#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 割合又は被所有 割合 (%)	関係内容
(その他の関係会社) エルピーダメモリ㈱	東京都中央区	236,143	半導体素子・集積 回路の製造・販売	被所有 39.6	テスト業務受託 研究開発受託
(連結子会社) ㈱テラミクロス	東京都青梅市	300	ウエハレベルパッケ ージ受託	所有 100.0	役員の兼任等…有
TeraPower Technology Inc.	台湾 新竹縣	NT\$870百万	半導体ウエハテスト 受託	所有 51.0	役員の兼任等…有

(注) 1. エルピーダメモリ株式会社は平成24年2月27日に東京地方裁判所に対し会社更生手続の申立を行い、同年3月23日に会社更生手続の開始決定がなされております。また、同社は平成24年8月21日に更生計画案を同裁判所に提出し、平成25年2月28日に更生計画が認可決定されております。

2. 株式会社テラミクロスは売上高の連結売上高に占める割合が10%を超えています。

主要な損益情報等	(1) 売上高	4,261百万円
	(2) 経常損益	△981百万円
	(3) 当期純損益	△624百万円
	(4) 純資産額	1,032百万円
	(5) 総資産額	3,707百万円

#### 5 【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数 (人)
メモリ事業	261 (51)
システムLSI事業	307 (74)
全社 (共通)	102 (6)
合計	670 (131)

(注) 1. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。）であり、嘱託社員及び派遣社員は、当連結会計年度末までの1年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

##### (2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数 (人)	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年)	平均年間給与 (円)
317 (102)	38.1	4.50	6,067,818

(注) 1. 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。）であり、嘱託社員及び派遣社員は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

2. 従業員のセグメント毎の内訳は以下のとおりとなります。臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

メモリ事業	181名 (51名)
システムLSI事業	80名 (48名)
全社 (共通)	56名 (3名)

3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

##### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度の経済環境は、欧州の財政危機が継続する中、円高が継続するなど、輸出産業を中心に国内経済は厳しい状況が続いておりましたが、昨年末の政権交代を機に、円高の是正、証券市場の回復など国内経済は長年続いたデフレからの脱却に向けた動きが見られるようになりました。

当社グループが属する世界の半導体市場は、スマートフォンなど一部モバイル機器向けの製品は好調に推移したものの、PCやデジタル家電向け製品などでは低迷が続き、半導体市場全般は低調に推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは、テスト受託においては主要顧客のウエハ生産数量が低迷したことなどから低調に推移いたしました。また、WLP受託においては、一部顧客の製品切り替えや顧客の生産調整などにより受託数量が減少し、低迷いたしました。

このような状況により、当連結会計年度における当社グループの売上高は21,306百万円(前年同期比11.9%減)、営業損益は42百万円の損失(前年同期は2,709百万円の利益)、経常利益は101百万円(前年同期比95.8%減)、当期純利益は500百万円(前年同期は5,530百万円の損失)となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。なお、セグメント別の業績には連結調整額、為替換算レート調整額及びセグメント別に配分されない費用を含んでおりません。

#### (メモリ事業)

メモリ事業におきましては、主にモバイル機器に使用されるテスト時間の長い製品の受託数量は増加しましたが、主にPC向けに使用されるテスト時間の短い製品は大幅に受託数量が減少しました。

これらの結果、当連結会計年度のメモリ事業の売上高は15,248百万円(前年同期比22.8%減)、セグメント利益は1,869百万円(同62.4%減)となりました。

#### (システムLSI事業)

システムLSI事業のテスト受託におきましては、イメージセンサの受託が増加するなど比較的堅調に推移いたしました。

しかし、WLP受託では、モバイル機器向け製品の生産調整などの影響により受託数量が減少したため、稼働率が低迷し低調に推移いたしました。

これらの結果、当連結会計年度のシステムLSI事業の売上高は6,067百万円(前年同期比34.0%増)、セグメント損益は496百万円の損失(前年同期は998百万円の損失)となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は6,043百万円となり、前連結会計年度末比485百万円の増加（前年同期比8.7%増）となりました。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,543百万円の純収入（前年同期比23.1%の収入減）となりました。これは主に、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上8,724百万円により資金が増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,896百万円の純支出（前年同期比72.9%の支出減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,037百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、4,260百万円の純支出（前年同期比429.6%の支出増）となりました。これは主に、リース債務の返済による支出4,034百万円によるものです。

(参考) キャッシュ・フロー 関連指標の推移

	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期
自己資本比率 (%)	49.9	49.5	47.1	56.6
時価ベースの自己資本比率 (%)	—	43.3	19.5	25.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	1.35	1.52	1.36	1.20
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	29.9	44.3	38.9	42.2

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注) 1. いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 平成22年3月期の時価ベースの自己資本比率は、株式時価総額が算定不能ですので記載しておりません。

3. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

4. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

5. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当社グループの生産品は全て入庫後すぐに顧客のもとへ出荷されているため、生産実績は販売実績とほぼ同額となります。従いまして、生産実績の記載はしておりません。下記 (3) 販売実績をご参照ください。

### (2) 受注状況

当社グループの取引形態においては、当月の受注のほとんどが、同月中に出荷完了しているため、受注実績は販売実績とほぼ同額となります。従いまして、受注状況の記載はしておりません。下記 (3) 販売実績をご参照ください。

### (3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)	
	金額 (千円)	前年同期比 (%)
メモリ事業	15,248,691	△22.8
システムLSI事業	6,067,946	34.0
調整額 (注1)	△10,359	—
合計	21,306,278	△11.9

- (注) 1. 調整額は、円換算に用いた為替相場の相違による差異調整額、及び連結消去であります。  
2. 前連結会計年度及び当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)		当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)	
	金額 (千円)	割合 (%)	金額 (千円)	割合 (%)
エルピーダメモリ㈱	16,025,269	66.2	12,408,554	58.2

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3 【対処すべき課題】

当社グループの主要な取引先であるエルピーダメモリ株式会社の更生計画が平成25年2月28日に認可され、当社へのウエハテスト業務の委託は継続していることから、当社グループは「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」が解消されたものと判断し、当該記載を解消することといたしました。

### (1) 新たな市場の開拓

当社グループは、特定の顧客や製品分野への依存度が高いことから、新規顧客・分野への展開が必要と考えております。

テストに関しては、既に国内顧客の海外展開に合わせ、台湾子会社においてISO/TS16949（自動車産業向け品質マネジメントシステム）の認証を取得しており、今後は日本と台湾の両拠点で車載半導体のテスト受託を強化してまいります。

WLPに関しては、顧客の製品付加価値を高められる新技術の開発により幅広い半導体製品への展開を行い、新市場の創出を目指してまいります。また、財務体質の健全性に留意しつつ、ターンキーサービスを拡充してまいります。

### (2) 更なる生産性の向上

当社グループの事業の特徴として、設備の固定費負担が大きく、稼働状況が収益に大きく影響いたします。

既存の保有設備においては、その稼働率向上に向けた営業活動の強化や、グループ全体での生産体制の見直し、他社との協力関係の構築などにより、安定的に高稼働率を維持できる体制の構築を目指します。

また、グループ全体の人員配置を見直し、業務の効率化と経費の削減を推進してまいります。

#### 4【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

##### (1) エルピーダメモリ株式会社との関係について

###### ① 資本関係について

当連結会計年度末現在における当社の総株主の議決権のうち39.64%をエルピーダメモリ株式会社が保有しており、当社はエルピーダメモリ株式会社の関連会社であります。

大株主としてのエルピーダメモリ株式会社による当社株式の株主権行使が、当社の他の株主の利益と一致しない可能性があります。

###### ② エルピーダメモリ株式会社との取引について

前連結会計年度及び当連結会計年度における当社グループとエルピーダメモリ株式会社との間の主な取引は以下のとおりであります。これらの取引は、当社グループとエルピーダメモリ株式会社との取引関係の変化又は取引条件の変化によって、その内容や規模が変動し、又は終了する可能性があります。

前連結会計年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の関係会社	エルピーダメモリ(株)	東京都中央区	236,143	半導体製品の開発・設計、製造、販売	(被所有)直接39.6	ウェハテスト業務受託設備の賃借	製品の販売(注)1	15,615,319	売掛金	618,829
									破産更生債権等(注)3	2,732,746
							設備賃借料、電力料他の立替(注)2	2,132,687	買掛金	1,003
									未払金	284,416
		未払費用	124,339							

当連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の関係会社	エルピーダメモリ(株)	東京都中央区	236,143	半導体製品の開発・設計、製造、販売	(被所有)直接39.6	ウェハテスト業務受託設備の賃借	製品の販売(注)1	11,996,729	売掛金	1,202,789
									破産更生債権等(注)5	844,842
							治工具の代理購買(注)4	432,374	未収入金	368,241
							設備賃借料、電力料他の立替(注)2	1,792,503	買掛金	1,230
	未払費用	116,204								

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 製品の販売価格は、総コストを勘案して交渉により決定しております。

2. 設備賃借料については、対象資産の償却費に固定資産税、保険料、金利相当額を加えた価格で取引を行っております。電力料については、当社の電力使用量に応じた電気料金相当額の請求となっております。他の立替の主な要素である業務委託料については、当社に対する用役提供の割合に応じた人件費相当額の請求となっております。

3. エルピーダメモリ株式会社への破産更生債権等に対し、2,331,548千円の貸倒引当金を計上しております。また前連結会計年度において2,331,548千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。なお、貸借対照表及び損益計算書上の計上額との差額は、治工具売却に伴うものです。

4. 治工具の代理購買については、市場価格を参考にして交渉の上、決定しております。

5. エルピーダメモリ株式会社への破産更生債権等に対し、391,624千円の貸倒引当金を計上しております。また当連結会計年度において412,985千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。なお、貸借対照表及び損益計算書上の計上額との差額は、治工具売却に伴うものです。

(2) 特定顧客への依存について

当社グループは、エルピーダメモリ株式会社を主要顧客として事業を展開しております。当社グループにおけるエルピーダグループへの売上比率の推移は以下のとおりとなっております。

	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
売上比率	73.0%	67.5%	60.7%
内、エルピーダメモリ(株)分	70.6%	66.2%	58.2%

エルピーダメモリ株式会社が、事業の再建を目指す過程で生産数量や生産品種の見直しを行うことにより、当社グループへのテスト業務の委託を大きく減少させた場合には、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また当社グループが業務を受託しているその他の主要顧客のいずれかが、当社グループへのテスト業務の委託やWLPの委託を大きく減少させた場合、又は何らかの理由により顧客の事業環境に大きな変化が生じた場合等には、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社グループは、エルピーダメモリ株式会社が平成24年2月27日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申し立てを行ったことから、平成24年3月期から平成25年3月期第3四半期まで「継続企業の前提に関する注記」を記載しておりましたが、平成25年2月28日に同社提出の更生計画を同裁判所が認可決定し、当社へのウエハテスト業務の委託は継続しているため、当連結会計年度末より当該注記は記載しておりません。

(3) 経済状況について

当社グループが業務を受託する半導体製品は、スマートフォンなどのモバイル機器を中心に、PC、デジタル家電など幅広い分野で使用されております。これらの最終製品の市場動向、顧客の生産動向、同業他社との競争、為替相場の変動等といった当社グループを取り巻く経済状況の変化は、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの資産には多額の固定資産が含まれており、当社顧客が当社グループに委託する業務内容（品種、数量、価格等）によっては、これらの固定資産の稼働率が低下する可能性があります。このような場合には当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 資金について

当社グループの事業は設備投資に多額の資金が必要であり、現状の事業計画においても新たなビジネスの獲得に伴う設備投資が予定されています。これらの設備投資に関して、必要な資金の確保は可能であると判断しておりますが、経済環境の急激な変動等により予定していた資金の確保が出来なくなった場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 知的財産について

当社グループが特許等の知的財産権を取得しようとする場合に、適時に特許等の登録を受けられるとは限りませんし、あるいは第三者が保有する知的財産権についての実施許諾を適時に受けられ、かつ継続できるとは限りません。また、当社グループも第三者から知的財産権の侵害や、実施許諾等に関する違反を主張される可能性があります。その場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 技術革新による影響について

当社グループの属する半導体業界は、製品の高機能化、低価格化が急激に進行する技術革新の速度が非常に速いという特徴があります。このため、画期的な技術開発がなされた場合、当社グループの保有する設備、技術が陳腐化する可能性があり、その場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 自然災害等について

当社グループの事業拠点は、神奈川県横浜市港北区、広島県東広島市、熊本県葦北郡芦北町、東京都青梅市及び台湾新竹縣に立地しており、当地及びその周辺で地震、台風等の自然災害、事故又はその他当社グループがコントロールできない事象が発生した場合、操業の停止等様々な損害を受ける可能性があります。当社グループは損害保険に加入しておりますが、考える全ての損失について保険に加入しているわけではなく、当社グループの受ける損失の全てが保険により補填される保証はありません。そのため、上記のような事象が発生した場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 特定サプライヤーへの依存について

当社グループは、生産設備、原材料等について、供給に関連する問題の発生を回避するため、複数の供給者と緊密な関係を構築するように努めております。しかし、設備・治具、原材料等の中には特定の供給元からしか入手できないものも含まれているため、需給が逼迫した場合の供給能力不足や供給元の事故等により、これらを適切なタイミングで調達できない可能性があります。また、調達できる場合でも調達価格が大幅に上昇するなど、当社グループの事業活動に支障が生じ、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 顧客資産管理について

当社グループは顧客の製品であるウエハや顧客の資産であるプローブカード等の支給を受けて業務を行っております。これらの製品及びプローブカード等は高価であり、その扱いには細心の注意を払っておりますが、事故等でこれらを破損した場合、その損害を賠償することとなります。当社グループは、保険契約によりこれら受託品の事故に対して備えておりますが、全ての補償を可能にするものではなく、事故等の発生により当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、顧客の資産を破損した場合、顧客の信用を失い、業務の受託が極端に減少する可能性があります。その場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10) 情報管理について

当社グループは顧客からのテスト受託にあたり、テストプログラムなど顧客の重要情報を取り扱っております。これらの重要情報の取扱については細心の注意を払い、情報管理を徹底しておりますが、情報漏洩等が発生した場合、顧客の信用を失い、テスト業務の受託が極端に減少する可能性があります。その場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(11) 品質について

当社グループは顧客からのテスト受託、WLP受託にあたり、要求された品質を満たすべく注力しております。しかしながら、顧客の要求する品質を満たせない状況が発生した場合、顧客の信用を失い、業務の受託が極端に減少する可能性があります。その場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。



## 5 【経営上の重要な契約等】

### (1) 半導体テストサービスに関する契約

契約会社名	契約締結先	内容	契約締結日	契約期間
(株)テラプローブ	エルピーダメモリ(株)	取引基本契約 (注)1	平成17年10月1日	平成17年10月1日から平成18年9月30日まで以後1年ごとの自動更新
(株)テラプローブ	エルピーダメモリ(株)	開発委託基本契約 (注)2	平成17年10月1日	平成17年10月1日から平成20年9月30日まで以後1年ごとの自動更新
(株)テラプローブ	エルピーダメモリ(株)	ウエハテスト委託に関する基本合意 (注)3	平成22年4月28日	平成22年3月1日から平成27年2月28日まで以後2年ごとの自動更新

(注) 1. 当契約の内容は取引の一般的、基本的な事項を定めたものであります。

2. 当契約の概要は以下のとおりです。

当社はエルピーダメモリ株式会社が生産する半導体の検査に関する技術開発について受託することで合意しております。当契約に基づき新たに生じた知的財産はエルピーダメモリ株式会社に帰属する旨合意しております。

3. 当契約の概要は以下のとおりです。

当社とエルピーダメモリ株式会社はエルピーダメモリ株式会社が生産するウエハのテストについて、当社の提供する品質、価格等が競争力を有することを条件として継続的かつ安定的な当該テストの履行確保の必要性を考慮して別途両者が協議し合理的に定める範囲で、当社が受託する旨合意しております。また、当社の業績が著しく悪化した状況において、エルピーダメモリ株式会社からのウエハテストを受託するために必要な設備を当社が売却する場合には、購入を希望する第三者と同等以上の条件でエルピーダメモリ株式会社が当該設備を購入することが出来る旨合意しております。

### (2) 合弁会社設立に関する契約

契約会社名	契約締結先	内容	出資額	合弁会社名	契約締結日
(株)テラプローブ	Powertech Technology Inc. (PTI)	ウエハテスト事業の合弁会社設立	当社 382.5百万台湾ドル PTI 367.5百万台湾ドル	TeraPower Technology Inc.	平成20年7月30日

(注) 合弁会社設立に合わせ、Powertech Technology Inc. より、ウエハテストに関する事業を549,626千台湾ドルで譲り受けております。

## 6 【研究開発活動】

当社グループでは半導体テストの受託及びWLPの受託を主力事業としており、研究開発活動はテスト技術及びWLPに関するものに集中しております。また、当社独自の取り組みよりも、受託業務に関連した開発内容が中心であることが当社の研究開発活動の特徴となっております。

半導体製品の微細化・高機能化に伴い、テスト技術についても多くの新たな開発案件が出てきており、顧客の要求の実現とビジネス拡大のためには研究開発活動が益々重要となってきました。先端テストに関する研究開発が顧客とのパートナーシップ構築に不可欠となってきております。

また、モバイル機器の普及により、半導体製品の小型化、薄型化が重要となっており、WLPについては、多ピン化並びに基盤内蔵WLPなどへの対応が必要となってきております。

当連結会計年度における主要な研究開発活動といたしましては、メモリ事業では、顧客製品の微細化、高機能化、高速化などに対応するテスト技術の開発であります。

半導体の微細化に伴う、テストコストの増加を抑制するため、同時測定個数向上と測定品質を両立させる技術、また、ウエハ状態での高速テストのニーズに対応したハイスピードテスト技術を開発いたしました。

システムLSI事業においては、アナログ製品の新規受託に向けたテスト技術を確立することで、新規顧客からの受託を開始することが出来ました。

また、半導体の実装スペースを最小限に抑えるため、基盤内蔵WLPの製品化に向けて研究開発を進めております。

但し、これらの研究開発は事業活動に密接に関わる内容であるため、売上原価として処理しており、研究開発費は計上しておりません。

## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

#### ① 繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産の回収可能性を検討し、評価性引当金を設定することにより減額しております。評価性引当金の必要性を検討するに当たり、将来の課税所得を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の検討は毎期行っており、計上されている繰延税金資産の金額と回収見込み金額との差額は、法人税等調整額に計上され、当期純利益を増減させることとなります。

#### ② 固定資産の減損

当社グループでは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、前連結会計年度において帳簿価額の回収が困難と見込まれる固定資産につき減損処理を行っております。なお、前述以外の固定資産については、将来の収益計画に基づき減損処理の必要性を判断していますが、将来の収益獲得が見込めなくなった場合には、減損損失が発生する可能性があります。

#### ③ 退職給付債務

当社の従業員退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づいて算出しております。実際の結果が前提条件と相異した場合又は前提条件を変更した場合、その影響額は数理計算上の差異として認識し、将来にわたり均等に償却することから、退職給付債務及び費用に影響を及ぼします。

#### ④ 貸倒引当金

当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、貸倒引当金を計上しております。なお、相手先の財政状態の悪化により支払能力が低下した場合、引当金の追加計上が必要になる場合があります。

### (2) 経営成績の分析

当連結会計年度の経済環境は、欧州の財政危機が継続する中、円高が継続するなど、輸出産業を中心に国内経済は厳しい状況が続いておりましたが、昨年末の政権交代を機に、円高の是正、証券市場の回復など国内経済は長年続いたデフレからの脱却に向けた動きが見られるようになりました。

当社グループが属する世界の半導体市場は、スマートフォンなど一部モバイル機器向けの製品は好調に推移したものの、PCやデジタル家電向け製品などでは低迷が続き、半導体市場全般は低調に推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは、テスト受託においては主要顧客のウエハ生産数量が低迷したことなどから低調に推移いたしました。また、ウエハレベルパッケージ（WLP）受託においては、一部顧客の製品切り替えや顧客の生産調整などにより受託数量が減少し、低迷いたしました。

#### (売上高)

当連結会計年度における売上高は、21,306百万円となり、前連結会計年度と比較して2,883百万円の減少となりました。その主な要因は、メモリ事業におきまして、PC向けDRAM市場の悪化に伴い、顧客の生産調整などが行われたことによるものです。

#### (売上原価)

当連結会計年度における売上原価は、19,119百万円となり、前連結会計年度と比較して274百万円の減少となりました。その主な要因は、一部資産の償却終了などにより減価償却費が減少したことによるものです。

#### (販売費及び一般管理費)

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、2,229百万円となり、前連結会計年度と比較して143百万円の増加となりました。その主な要因は、システムLSI事業におきまして、株式会社テラミクロスの販売費及び一般管理費が前連結会計年度の下期から加わったことによるものです。

#### (営業損失)

上記の諸要因により、当連結会計年度は、42百万円の営業損失を計上する結果（前連結会計年度は2,709百万円の利益）となりました。

(営業外収益)

当連結会計年度における営業外収益は、577百万円となり、前連結会計年度と比較して410百万円の増加となりました。その主な要因は、エルピーダメモリ株式会社の更生計画が認可決定されたことに伴い、貸倒引当金戻入益を計上したことによるものです。

(営業外費用)

当連結会計年度における営業外費用は、434百万円となり、前連結会計年度と比較して41百万円の減少となりました。その主な要因は、一部リース資産の契約満了により支払利息が減少したことによるものです。

(経常利益)

上記の諸要因により、当連結会計年度における経常利益は、101百万円となり、前連結会計年度と比較して2,300百万円の減少となりました。

(特別利益)

当連結会計年度における特別利益は、260百万円となり、前連結会計年度と比較して809百万円の減少となりました。その主な要因は、前連結会計年度において株式会社テラミクロスを株式取得により連結子会社としたことに伴う負ののれん発生益559百万円を計上したことによるものです。

(特別損失)

当連結会計年度における特別損失は、4百万円となり、前連結会計年度と比較して8,191百万円の減少となりました。その主な要因は、前連結会計年度においてエルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い、同社向け債権に対して計上した貸倒引当金2,701百万円、及び当社九州事業所で保有している固定資産の減損処理に伴う減損損失として5,388百万円を計上したことによるものです。

(当期純利益)

上記の諸要因により、当連結会計年度における当期純利益は、500百万円（前連結会計年度は5,530百万円の損失）となりました。

(3) 財政状態に関する分析

(資産)

当連結会計年度末における総資産は35,542百万円となり、前連結会計年度末比5,546百万円の減少となりました。これは主に、償却などにより有形固定資産が5,906百万円減少したことによるものです。

(負債)

負債は13,304百万円となり、前連結会計年度末比6,585百万円の減少となりました。これは主に、返済によりリース債務が3,964百万円減少、設備購入代金の支払い等により未払金が1,771百万円減少したことによるものです。

(純資産)

純資産は22,237百万円となり、前連結会計年度末比1,039百万円の増加となりました。これは主に、当期純利益の計上による利益剰余金の増加500百万円、少数株主持分の増加284百万円によるものです。これらの結果、自己資本比率は56.6%となり、前連結会計年度末比9.5ポイント増加いたしました。

(4) キャッシュ・フローの状況に関する分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は6,043百万円となり、前連結会計年度末比485百万円の増加（前年同期比8.7%増）となりました。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,543百万円の純収入（前年同期比23.1%の収入減）となりました。これは主に、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上8,724百万円により資金が増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,896百万円の純支出（前年同期比72.9%の支出減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,037百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、4,260百万円の純支出（前年同期比429.6%の支出増）となりました。これは主に、リース債務の返済による支出4,034百万円によるものです。

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループは、半導体のテスト受託を主な事業としており、この事業は受託量の増加や受託対象製品の増加に際して、使用する測定装置等の投資が先行し、数年にわたって回収していく構造となっております。従って、所要資金の調達については、割賦等の長期安定的な調達方法を取ることに留意しております。この結果、キャッシュ・フローに関し、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては減価償却費が、財務活動によるキャッシュ・フローにおいてはリース債務等の長期有利子負債の返済による支出が、それぞれ主な構成要素となっております。また、営業活動によるキャッシュ・フローについては損益の状況が、投資活動によるキャッシュ・フローについては新規設備投資の増減が、それぞれ主な変動要因となっております。

従いまして、手許流動性、すなわち、現金及び現金同等物の水準については、業績の変動に対応するため、連結売上高の3ヶ月分以上の確保が望ましいと考えております。当連結会計年度末においては、現金及び現金同等物の残高は6,043百万円であり、当連結会計年度売上高の約3ヶ月分を確保しております。

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの売上は、特定顧客への依存度が高いため、当該顧客の生産動向が当社業績に大きな影響を与えます。例えば、当社グループの主力受託品であるDRAMは、スマートフォンやタブレットなどに使用されるテスト時間の長い製品(モバイルDRAM)と主にPCに使用されるテスト時間の短い製品に分かれ、テスト時間の長いモバイルDRAMの生産量の増減や製品ミックスの変化によるテスト装置の稼働率の変化が当社業績に影響を与えます。

また、当社グループの主要顧客であるエルピーダメモリ株式会社が、今後の事業を進める中で、当社グループの受託量が増減する可能性があり、当社業績に影響を与える可能性があります。

当社グループといたしましては、特定の顧客に依存することなく、より多くの顧客から、様々な種類の製品を受託するべく、営業活動を強化しております。

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

世界経済の減速傾向が強まる中、半導体市場においても厳しい事業環境が継続すると考えております。このような状況の中で、当社グループは、既存の人的能力と設備能力を最大限に引き出し、企業価値の向上を目指してまいります。

具体的には、テストとWLPの両分野において技術提案力、開発力、治工具設計力と、高品質で効率的なオペレーションを実現する工程運営能力を有する経験豊富なエンジニアと、世界的な規模を有するメモリテストを中心に各種のテストを備えた日本と台湾の生産拠点を活用し、他社との差別化を図り、顧客開拓、受託製品の増加を目指すことであります。特に、当社グループが有するテスト技術と信頼性の高いWLP技術の組み合わせによるターンキーサービスの積極的な営業活動を展開してまいります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、テスト受託能力増強及び新規テスト受託に伴うテスト装置導入のために設備投資を実施し、当連結会計年度の設備投資の総額は1,935,197千円(無形固定資産及び調整額等を含む)となりました。

なお、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

##### (1) メモリ事業

メモリ事業の設備投資額は、1,143,486千円であります。これらは主に、新たに受託したテスト業務のための設備の取得、及び顧客の生産品がテスト負荷の高い製品にシフトし当社の受託するテストの負荷が増加したことに対応するための設備の取得であります。

##### (2) システムLSI事業

システムLSI事業の設備投資額は、1,073,903千円であります。これらは主に、新たに受託したテスト業務のための設備の取得、及び新日鉄住金マテリアルズ株式会社からのボール搭載(半田端子形成)工程にかかる設備の譲受であります。

当連結会計年度において、稼働の低下した生産設備の売却を行っており、売却額はメモリ事業において251,816千円、システムLSI事業において41,270千円であります。なお、重要な設備の除却はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

##### (1) 提出会社

平成25年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額					従業員数 (人)
			建物 (千円)	機械及び 装置 (千円)	土地 (千円) (面積㎡)	その他 (千円)	合計 (千円)	
本社・開発センター (神奈川県横浜市港北区)	全事業	本社・ 事務所	22,417	—	—	11,314	33,732	58 (3)
開発センター分室 (神奈川県相模原市中央区)	メモリ 事業	半導体 検査設備他	4,169	—	—	981	5,151	—
広島事業所 (広島県東広島市)	メモリ 事業	半導体 検査設備他	299,969	13,365,459	—	998,196	14,663,624	179 (51)
九州事業所 (熊本県葦北郡芦北町)	メモリ 事業 システム LSI事業	半導体 検査設備他	646,205	1,016,024	64,948 (58,660)	381,042	2,108,220	80 (48)

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、構築物、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。なお上記金額には消費税等を含めておりません。
2. 帳簿価額は「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の適用後の金額を表示しております。
3. 本社・開発センター、開発センター分室及び広島事業所は土地及び建物を賃借しており、年間の賃借料は363,136千円であります。
4. 従業員数の( )は、当連結会計年度末までの1年間の臨時雇用者数の平均を外書しております。
5. 開発センター分室は常駐者はありません。
6. リース契約による主な賃借設備は、以下のとおりであります。

事業所名(所在地)	設備の内容	数量	リース期間 (年)	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
広島事業所 (広島県東広島市)	半導体検査設備 (ファイナンス・リース)	一式	2～5	3,112,999	6,281,481
九州事業所 (熊本県葦北郡芦北町)	半導体検査設備 (ファイナンス・リース)	一式	5～8	404,308	716,051

## (2) 国内子会社

平成25年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額					従業員数 (人)
				建物 (千円)	機械及び 装置 (千円)	土地 (千円) (面積㎡)	その他 (千円)	合計 (千円)	
(株)テラミクロス	本社・工場 (東京都青梅市)	システム LSI事業	半導体 組立設備他	370,109	624,488	473,000 (7,286)	373,340	1,840,938	225 (29)

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、構築物、車両運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。なお上記金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の( )は、当連結会計年度末までの1年間の臨時雇用者数の平均を外書しております。

3. リース契約による主な賃借設備は、以下のとおりであります。

事業所名(所在地)	設備の内容	数量	リース期間 (月)	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
本社・工場 (東京都青梅市)	半導体組立設備 (ファイナンス・リース)	一式	33~60	447,399	261,499

## (3) 在外子会社

平成25年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額					従業員数 (人)
				建物 (千円)	機械及び 装置 (千円)	土地 (千円) (面積㎡)	その他 (千円)	合計 (千円)	
TeraPower Technology Inc.	本社・工場 (台湾新竹縣)	メモリ事業 システム LSI事業	半導体 検査設備他	1,731,256	2,053,030	409,176 (6,135)	125,766	4,319,229	128

(注) 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。なお上記金額には消費税等を含めておりません。

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

## (1) 重要な設備の新設等

当社グループは、新規テスト受託に伴うテスト装置導入及びテスト受託能力の強化を目的として、継続的に設備投資を行っております。当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修計画等は次のとおりであります。

社名	所在地	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		着手及び 完了予定年月		完成後の 増加能力	資金調達 方法
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	着手	完了		
(株)テラプローブ	広島県 東広島市	メモリ 事業	半導体検査 設備	299	7	平成 25年4月	平成 26年3月	—	自己資金
(株)テラプローブ	熊本県葦北 郡芦北町	システム LSI事業	半導体検査 設備	1,412	0	平成 25年4月	平成 26年3月	—	自己資金
(株)テラミクロス	東京都 青梅市	システム LSI事業	半導体組立 設備	187	5	平成 25年4月	平成 26年3月	—	自己資金
TeraPower Technology Inc.	台湾 新竹縣	メモリ事業 システム LSI事業	半導体検査 設備	610	17	平成 25年4月	平成 26年3月	—	自己資金

(注) 完成後の増加能力につきましては、合理的な算出が困難なため、記載を省略しております。

## (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	30,000,000
計	30,000,000

##### ②【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成25年6月26日)	上場金融商品取 引所名又は登録 認可金融商品取 引業協会名	内容
普通株式	9,282,500	9,282,500	東京証券取引所 (マザーズ)	完全議決権株式であり、権利内容 に何ら制限の無い当社の標準とな る株式で、単元株式数は100株で あります。
計	9,282,500	9,282,500	—	—

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成25年6月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。



(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

平成20年2月15日臨時株主総会決議

区分	事業年度末現在 (平成25年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成25年5月31日)
新株予約権の数(個)	4,319 (注)1	4,310 (注)1
新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる 株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる 株式の数(株)	431,900 (注)1,2,3	431,000 (注)1,2,3
新株予約権の行使時の 払込金額(円)	1株当たり 2,650(注)3,4	1株当たり 2,650(注)3,4
新株予約権の行使期間	自 平成22年3月1日 至 平成27年3月31日	同左
新株予約権の行使により株式 を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額(円)	発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3	発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3
新株予約権の行使の条件	(1)新株予約権の割当を受けた者は、割当日から権利行使に至るまでの間、当社又は当社がその総株主の議決権の過半数を直接又は間接に保有している会社の従業員、執行役員、取締役もしくは監査役の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 (2)新株予約権の相続による継承は、新株予約権の割当を受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を継承することが出来ない。 (3)割当日から権利行使に至るまでの間、新株予約権の質入れその他の担保権を設定した場合は、行使を認めない。 (4)その他の条件については、当社株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「株式会社テラプローブ新株予約権付与契約書」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する 事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項	—	—

(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株予約権の数及び新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及びその目的となる株式の数を減じております。

2. 本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数(以下、「付与株式数」といいます。)は、新株予約権付与時には10株とします。なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数(以下、「未発行付与株式数」といいます。)について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式} \times \text{株式分割又は株式併合の比率}$$

当社は、平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っているため、提出日現在、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は100株となっております。

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができます。

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

3. 平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記の表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の数で記載しております。
4. 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の割合}}$$

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たりの払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。

また、新株予約権発行後、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で払込金額の調整を行うことができます。

区分	事業年度末現在 (平成25年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成25年5月31日)
新株予約権の数(個)	471(注)1	471(注)1
新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる 株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる 株式の数(株)	47,100 (注)1,2,3	47,100 (注)1,2,3
新株予約権の行使時の 払込金額(円)	1株当たり 2,650(注)3,4	1株当たり 2,650(注)3,4
新株予約権の行使期間	自 平成24年4月1日 至 平成29年3月31日	同左
新株予約権の行使により株式 を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額(円)	発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3	発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3
新株予約権の行使の条件	(1)新株予約権の割当を受けた者は、割当日から権利行使に至るまでの間、当社又は当社がその総株主の議決権の過半数を直接又は間接に保有している会社の従業員、執行役員、取締役もしくは監査役の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 (2)新株予約権の相続による継承は、新株予約権の割当を受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を継承することが出来ない。 (3)割当日から権利行使に至るまでの間、新株予約権の質入れその他の担保権を設定した場合は、行使を認めない。 (4)その他の条件については、当社株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「株式会社テラプローブ新株予約権付与契約書」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する 事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項	—	—

(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株予約権の数及び新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及びその目的となる株式の数を減じております。

2. 本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数(以下、「付与株式数」といいます。)は、新株予約権付与時には10株とします。なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数(以下、「未発行付与株式数」といいます。)について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

当社は、平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は100株となっております。

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができます。

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

3. 平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記の表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の数で記載しております。
4. 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の割合}}$$

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たりの払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。  
 また、新株予約権発行後、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で払込金額の調整を行うことができます。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済普通株式総数増減数(株)	発行済普通株式総数残高(株)	発行済A種類株式総数増減数(株)	発行済A種類株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成21年 3月1日(注)1	112,000	372,000	—	508,000	—	9,600,000	—	9,156,955
平成21年 3月24日(注)1	368,000	740,000	—	508,000	—	9,600,000	—	9,156,955
平成22年 3月11日(注)1	28,000	768,000	—	508,000	—	9,600,000	—	9,156,955
平成22年 3月31日(注)2	—	768,000	△508,000	—	—	9,600,000	—	9,156,955
平成22年 5月28日(注)3	6,912,000	7,680,000	—	—	—	9,600,000	—	9,156,955
平成22年 12月15日(注)4	1,600,000	9,280,000	—	—	2,220,000	11,820,000	2,220,000	11,376,955
平成22年 4月1日～ 平成23年 3月31日(注)5	2,500	9,282,500	—	—	3,312	11,823,312	3,312	11,380,267

- (注) 1. 株主からの請求により、当社A種類株式1株につき当社普通株式1株を交付したことにより発行済株式総数が増加しております。
2. 平成22年3月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年3月31日に自己株式508,000株(A種類株式)を消却しております。
3. 平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を実施し、発行済株式総数が6,912,000株増加し、7,680,000株となっております。
4. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)  
発行価格 3,000円 引受価額 2,775円  
資本組入額 1,387.50円 払込金総額 4,440,000千円
5. 新株予約権の行使による増加であります。

## (6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）							単元未満株式の状況（株）	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	6	17	33	53	4	2,314	2,427	—
所有株式数(単元)	—	5,423	2,130	44,719	25,838	61	14,645	92,816	900
所有株式数の割合(%)	—	5.84	2.29	48.18	27.84	0.07	15.78	100	—

(注) 自己株式41株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。

## (7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
更生会社エルピーダメモリ株式会社	東京都中央区八重洲2丁目2番1号	3,680,000	39.64
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)	25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー)	1,129,300	12.16
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー)	770,200	8.29
株式会社アドバンテスト	東京都練馬区旭町1丁目32-1号	760,000	8.18
UBS AG HONG KONG (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	AESCHENVORSTADI 1 CH-4051 BASEL SWITZERLAND (東京都品川区東品川2丁目3番14号)	305,800	3.29
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	218,700	2.35
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10	140,100	1.50
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	139,600	1.50
立花証券株式会社	東京都中央区日本橋小網町7番2号 べんてるビル	96,300	1.03
神林 忠弘	新潟県新潟市中央区	94,300	1.01
計	—	7,334,300	79.01

(注) 1. 持株比率は小数点第3位を切り捨てて表示しております。

2. パワーテックテクノロジー インク (POWERTECH TECHNOLOGY INC.) から、平成22年12月24日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成22年12月16日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

大量保有者	パワーテックテクノロジー インク (POWERTECH TECHNOLOGY INC.)
住所	NO. 26, DATONG RD., HSINCHU INDUSTRIAL HUKOU TOWNSHIP, HSINCHU COUNTY 303, TAIWAN
保有株券等の数	1,040,000株
株券等保有割合	11.21%

## (8) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成25年3月31日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	—	—	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 9,281,600	92,816	権利内容に何ら制限の無い当社の標準となる株式であります。
単元未満株式	普通株式 900	—	—
発行済株式総数	9,282,500	—	—
総株主の議決権	—	92,816	—

## ② 【自己株式等】

平成25年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数 (株)	他人名義所有株式数 (株)	所有株式数の合計 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%)
—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

(平成20年2月15日臨時株主総会決議)

会社法に基づき、平成20年2月15日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年2月15日の臨時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日	平成20年2月15日
付与対象者の区分及び人数(名)	取締役及び監査役 9名 使用人 226名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	取締役及び監査役 84,000 使用人 393,800 (注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	—

(注) 平成22年5月28日付で当社普通株式1株を10株とする株式分割を行っており、上記株数は分割後の株数で記載しております。

(平成22年3月19日臨時株主総会決議)

会社法に基づき、平成22年3月19日臨時株主総会終結の時に在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年3月19日の臨時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日	平成22年3月19日
付与対象者の区分及び人数(名)	使用人 53名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	使用人 57,700 (注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	—

(注) 平成22年5月28日付で当社普通株式1株を10株とする株式分割を行っており、上記株数は分割後の株数で記載しております。



## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数 (株)	価額の総額 (千円)
当事業年度における取得自己株式	41	24
当期間における取得自己株式	—	—

### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数 (株)	処分価額の総額	株式数 (株)	処分価額の総額
引き受けるものの募集を行った取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、株式分割に係る移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他	—	—	—	—
保有自己株式数	41	—	41	—

### 3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題と位置づけており、その方針としては、企業価値の向上とのバランスに配慮しつつ、収益状況に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。

平成25年3月期においては、当期純利益を計上したものの利益剰余金が依然としてマイナスの状態であるため、誠に遺憾ながら配当等の利益還元を見送らせていただきます。今後については、利益剰余金のマイナスを解消し、各事業年度の財政状態、経営成績及び将来に向けた事業計画等を勘案しながら、配当による利益還元を検討してまいります。また、剰余金の配当にあたっては、期末配当による年1回を基本的な方針としております。

剰余金の配当を行う場合の決定機関は、期末配当については株主総会であり、毎年9月30日を基準日とする中間配当については取締役会である旨、定款に定めております。

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	—	—	3,120	2,425	1,180
最低(円)	—	—	1,670	501	491

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

なお、平成22年12月16日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月
最高(円)	640	634	624	798	1,065	1,180
最低(円)	531	538	580	599	675	865

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	全体統轄、 内部監査管掌 CEO (注3)	渡辺 雄一郎	昭和43年12月19日生	平成4年4月 日本電気(株) 入社 平成16年10月 エルピーダメモリ(株) 転籍 平成18年10月 同社 F&A Office コーポレ ートバジェットGr エグゼク ティブマネージャ 平成19年5月 同社 F&A Office ファイナ ンスGr エグゼクティブマネ ージャ 平成21年2月 EBS(株) 監査役 ECM(株) 監査役 平成21年8月 エルピーダメモリ(株) F&A Office コーポレートバジエ ットGr エグゼクティブマネ ージャ 平成22年6月 当社 入社 当社 取締役 システムLSI事 業部門・営業部門管掌兼執行 役員 システムLSI事業部総括 兼セールスオフィス総括 TeraPower Technology Inc. 取締役 平成23年6月 当社 代表取締役社長兼執行 役員CEO (現任) 当社 内部監査・システム LSIビジネス・ビジネス開 発・財務・経理管掌 平成24年6月 当社全体統轄、内部監査管掌 (株)テラミクロス 代表取締役 社長 (現任) 平成25年6月 当社 グループ統括、内部監 査管掌 (現任)	(注5)	3,100
代表取締役 副社長	クオリティア シュアラン ス・ファイナ ンス&アカウ ンティング・ アドミニスト レイティブ管 掌 CRO (注3)	小平 広人	昭和31年7月2日生	昭和55年4月 (株)アドバンテスト 入社 平成13年6月 Advantest Europe Corporation 出向 Deputy Managing Director 平成16年4月 (株)アドバンテスト 営業本部営業管理統括部 ビジネス支援部長 平成17年9月 当社 出向 取締役 平成19年4月 当社 取締役兼執行役員CAO 平成19年6月 当社 転籍 平成20年8月 TeraPower Technology Inc. Director 平成22年3月 当社 管理部門管掌 平成23年6月 当社 アドミニストレイティ プ管掌 平成24年6月 当社 代表取締役副社長兼執 行役員CAO クオリティアシ ュアランス・ファイナンス& アカウンティング・アドミニ ストレイティブ管掌 平成25年6月 当社 代表取締役副社長兼執 行役員CRO クオリティアシ ュアランス・ファイナンス& アカウンティング・アドミニ ストレイティブ管掌 (現任)	(注5)	500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(常勤)	メモリビジネス・システム LSIビジネス・ WLPビジネス・ グローバルセールス&マーケティング管掌 COO (注3)	横山 毅	昭和41年11月19日生	昭和60年4月 山口日本電気(株) 入社 平成12年7月 広島日本電気(株) 転籍 平成15年9月 広島エルピーダメモリ(株) 出 向 平成16年4月 同社 転籍 平成17年6月 同社 ウエハー測定部長 兼ウエハー測定技術部長 平成17年9月 当社 出向 取締役 平成19年4月 当社 取締役兼執行役員CPO 平成19年6月 当社 転籍 平成22年2月 当社 取締役兼執行役員 メモリ事業部長 平成22年3月 TeraPower Technology Inc. 取締役 当社 事業部門・営業部門管 掌 平成22年6月 当社 メモリ事業部門・品質 保証部門管掌 平成23年6月 当社 取締役兼執行役員メモ リビジネスユニット長 メモ リビジネス・品質保証管掌 平成23年10月 (株)テラミクロス 取締役 平成24年6月 当社 取締役兼執行役員COO メモリビジネス・システム LSIビジネス・グローバルマ ーケティング管掌 平成25年6月 当社 取締役兼執行役員COO メモリビジネス・システム LSIビジネス・WLPビジネス・ グローバルセールス&マーケ ティング管掌 (現任)	(注5)	500
取締役 (非常勤)	—	森 直樹	昭和46年6月28日生	平成13年10月 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所 平成17年10月 同事務所パートナー 平成18年3月 LM法律事務所 開設 同事務所パートナー (現任) 平成21年10月 (株)企業再生支援機構プロフェ ッショナル・オフィス デイ レクター 平成23年8月 コロナ工業(株) 社外監査役 (現任) 平成24年6月 当社 監査役 平成25年6月 当社 取締役 (現任)	(注6)	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	—	増子 尚之	昭和35年7月13日生	昭和59年4月 ㈱日立製作所 入社 平成10年7月 同社 半導体事業本部経理 部経理第二課 課長 平成12年6月 Hitachi Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd. 経理部 副部長 平成14年12月 エルピーダメモリ㈱ 経理部マネージャー 平成17年4月 広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長 平成19年5月 Rexchip Electronics Corporation Director CFO 平成22年6月 同社 CFO 平成23年6月 エルピーダメモリ㈱ 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱ 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. Supervisor 平成24年7月 当社 常勤監査役 (現任) ㈱テラミクロス 監査役 平成25年6月 TeraPower Technology Inc. Supervisor (現任)	(注7)	—
監査役 (非常勤)	—	縣 啓二	昭和21年12月2日生	昭和47年9月 ㈱アドバンテスト入社 平成5年6月 同社 取締役 平成11年6月 同社 常務取締役 平成15年6月 同社 取締役専務執行役員 平成17年9月 当社 監査役 平成20年6月 ㈱アドバンテスト 顧問 平成23年6月 当社 監査役 (現任)	(注8)	—
監査役 (非常勤)	—	檜垣 修	昭和29年1月26日生	昭和53年4月 旭エレクトロニクス㈱入社 昭和56年8月 三菱電機㈱ 入社 平成15年4月 ㈱ルネサステクノロジ 実装・テスト技術統括部 テ スト技術開発部 部長 平成22年4月 ルネサスエレクトロニクス㈱ 生産本部 実装・テスト技術 統括部 副統括部長 平成25年6月 当社 監査役 (現任)	(注9)	—
計						4,100

- (注) 1. 取締役 森 直樹は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 増子 尚之、縣 啓二及び檜垣 修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名です。
- 渡辺 雄一郎……執行役員CEO (Chief Executive Officer) …グループ統括、内部監査担当  
小平 広人……執行役員CRO (Chief Risk Management Officer) …グループリスク管理統括  
横山 毅……執行役員COO (Chief Operating Officer) 兼メモリビジネスユニット長…グループ・ビジネス統括  
池内 貴之……執行役員システムLSIビジネスユニット長  
岡田 修……執行役員WLPビジネスユニット長  
柴田 洋孝……執行役員CSO & CMO (Chief Sales Officer & Chief Marketing Officer)  
……グローバルセールス&マーケティング担当  
池田 実成……執行役員……台湾ビジネス担当  
瀬畑 貴史……執行役員CQO (Chief Quality Officer) …クオリティアシュアランス担当  
神戸 一仁……執行役員CFO (Chief Financial Officer) …ファイナンス&アカウンティング担当  
草下 永典……執行役員CAO (Chief Administrative Officer) …アドミニストレイティブ担当
4. 当社は法令に定める監査役の数に欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
松田 大介	昭和46年1月12日生	平成12年10月 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所 平成14年4月 第一東京弁護士会常議員 平成16年10月 光和総合法律事務所パートナー (現任) 平成18年4月 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長 平成18年10月 ㈱パテント・ファイナンス・コンサルティング 社外監査役 (現任) 平成23年6月 ㈱ルイファン・ジャパン 社外監査役 平成24年3月 当社 社外監査役	—

5. 平成24年6月25日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. 平成25年6月25日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7. 平成22年6月16日開催の定時株主総会で選任された太田利昌氏の補欠として就任しており、その任期は同氏の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8. 平成23年6月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
9. 平成25年6月25日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### ① 基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と位置づけております。その基本的な考え方は、経済・社会の構造的変化や急速に進展する半導体市場といった、当社を取り巻く経営環境の変化に迅速に対応できる業務執行体制を確立し、適切な管理・監督体制を構築することで、経営の効率化及び透明性の向上を図ることです。

#### ② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

##### イ. 会社の機関の基本説明

###### ・取締役会

当社の取締役会は、取締役4名（内1名が社外取締役）で構成されており、取締役の他、監査役が出席することになっております。取締役会は、原則として毎月1回開催しており、また迅速な意思決定を確保するために、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。取締役会は、当社の経営に関する重要事項について意思決定するとともに、執行役員による業務執行の監督を通して、全社の業務執行を監督しております。

###### ・監査役会

当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名（全て社外監査役）で構成されており、毎月1回の監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を随時開催しております。監査役会においては、経営の妥当性、コンプライアンスなどに関して幅広く意見交換や検証を行い、適宜取締役の意思決定に関して善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を監視、検証しております。

また、監査役は取締役会へ出席するほか、常勤監査役は必要に応じて他の社内の重要会議へも出席しており、全社の状況を把握しながら経営に対する監視機能を発揮できる体制となっております。

###### ・執行役員会

当社は、半導体業界の素早い動向変化に対応するため、業務執行に関する重要事項を協議・決定する機関として執行役員会を設置しております。執行役員会は、10名の執行役員で構成されており、原則として毎週1回開催しております。執行役員会は、取締役会が決定した基本方針に基づいて、一定範囲内の重要案件を決定するとともに、業務運営上重要な情報の共有を行っております。これにより、技術的、事業環境的な変化に迅速に対応し、適切な決定を適時行える経営体制を整えております。

###### ・役員報酬諮問委員会

当社は、役員報酬の公正性・妥当性を確保するために役員報酬諮問委員会を設置しております。役員報酬諮問委員会は、代表取締役を除く取締役・監査役・執行役員及び顧問弁護士の中から選任される、監査役1名以上を含む3名以上の委員で構成され、取締役及び執行役員の報酬について答申を行っております。

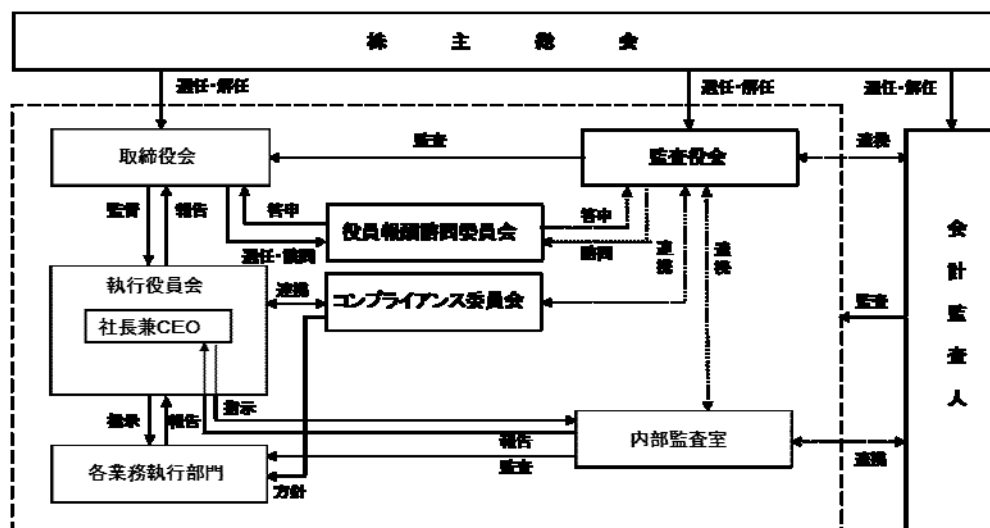
###### ・コンプライアンス委員会

当社は、グループ全体へのコンプライアンスの浸透と徹底を図ることを目的として、執行役員及び内部監査室長をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置しております。必要に応じて適宜同委員会を開催し、グループ全体のコンプライアンス推進の基本的な方針決定等の審議を行っております。

###### ・内部監査室

当社は、適切な業務の執行を検証するため、業務部門から独立した社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室は、専任者3名で構成され、業務執行部門の監査を行い、その結果を社長に直接報告しております。

ロ. 会社の機関・内部統制システム(図表)



ハ. 内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において「株式会社の業務の適正を確保する体制の整備に関する基本方針」を決議し、その内容に沿って内部統制システムの整備を行っております。

まず、当社の企業活動に際して全役職員が遵守する必要がある指針及び基準として、当社で「Tera Probe Code of Conduct」を制定し、イントラネットに掲載するとともに、全役職員がその名刺判のカードを携帯し、各自の行動の基準とするよう遵守の徹底を図っております。

コンプライアンスについては、法令及び社内規則等に対する違反行為の早期発見と是正を目的とした内部通報制度（コンプライアンス・ヘルプライン）を設け、法令上疑義のある行為等についての情報の確保に努めております。

これらに加え、内部監査室が、当社及び関係会社の業務執行部門を対象として内部監査を実施しております。

ニ. 内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査室は年間計画に基づいて業務執行部門の監査を行い、必要に応じて対象部門に対し問題点の指摘、改善の指導、助言などを行っております。また、過去の監査結果に対する改善状況の確認も行っております。さらに、会社の内部統制の整備、運用状況を日常的に監視するとともに、問題点の把握、指摘、改善勧告を行っております。内部監査の結果は、直接社長に報告書が提出されるとともに、監査役会でも報告が行われております。

また当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産の状況の調査を通して、取締役の職務執行を検証、監視しております。

内部監査室、監査役及び会計監査人は定期的に打合せを行い、監査状況などについて情報交換を行うなど連携を図っております。

ホ. 会計監査の状況

会計監査につきましては、当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。なお、当連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士は新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士上村純氏及び安藤隆之氏であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他12名により構成されております。

同監査法人は、既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

#### へ. 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の取締役4名のうち1名は社外取締役であります。また、監査役3名はそのすべてが社外監査役であります。

当社における各社外取締役及び社外監査役の人的関係、取引関係及びその他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割は、以下のとおりであります。

- ・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての経験により企業法務に関する豊富な見識を有しており、業務の適正性・健全性を確保する役割を担うものと考えております。当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。なお、当社は、同氏がパートナー弁護士を務めた光和総合法律事務所所属の弁護士と法律顧問契約を締結しております。また、同氏はLM法律事務所のパートナー弁護士及び㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・オフィスのディレクターを務めており、又は務めておりましたが、当社と同事務所及び同社との間には特別な関係はありません。
- ・社外監査役増子尚之氏は、半導体事業に関する豊富な経験を有しており、また、長年にわたる財務及び経理業務の経験を有しておりますので、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えております。なお、同氏はエルピーダメモリ㈱での職務を歴任しておりますが、同社は当社の大株主であり、当社は、同社から半導体テスト業務を継続的に受託しており、主要な取引先であります。また、当社及び当社の関係会社である TeraPower Technology Inc. は、同氏が Director を務めた Rexchip Electronics Corporation から半導体テスト業務を受託しております。また、同氏は秋田エルピーダメモリ㈱の監査役及びElpida Memory(Taiwan) Co., Ltd の Supervisor を務めており、当社は秋田エルピーダメモリ㈱から半導体テスト業務を受託しておりました。Elpida Memory (Taiwan)Co.,Ltd と当社との間に特別な関係はありません。
- ・社外監査役縣啓二氏は、企業経営の豊富な経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えております。なお、同氏は㈱アドバンテストでの職務を歴任しておりますが、同社は当社の大株主であり、当社は、同社から半導体検査設備を継続的に購入しております。
- ・社外監査役檜垣修氏は、半導体事業に関する豊富な経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えております。なお、同氏はルネサスエレクトロニクス㈱での職務を歴任しており、当社及び当社の関係会社である㈱テラミクロスは同社から半導体テスト業務を継続的に受託しております。

また、各社外取締役及び社外監査役の間には本書提出日現在、以下のとおり資本関係があります。

社外監査役 縣 啓二 (新株予約権 3,500株)

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については、特段定めておりません。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、以下のとおりであります。

- ・内部監査室は、内部監査の状況について年2回取締役会に報告し、必要に応じて監査役会に報告しており、社外取締役及び社外監査役は必要に応じて意見を述べております。
- ・監査役は、監査法人との相互連携により、適宜監査役会において議論し、社外監査役は必要に応じて意見を述べております。

#### ③ リスク管理体制の整備状況

当社は、会社全体のガバナンス体制構築のため、社内規則等を整備し、内部監査によってリスクの把握と改善を行っております。

当社は、Tera Probe Code of Conductを全社員が遵守するよう、コンプライアンスの徹底を図っております。加えて、全社の情報セキュリティを統括する組織として、情報セキュリティ委員会を設置しております。情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティに関する規程類の整備、システムや体制の構築等の検討、諸施策の実施、運用見直しの指示など、その活動を通して、個人情報保護と会社機密情報の漏洩防止の徹底を図っております。

さらに当社は、地震などの大規模災害による被災を想定し、速やかな事業再開を図るため、いわゆる事業継続計画(BCP)を策定しております。



④ 役員の報酬等の内容

イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

取締役報酬の総額	55,448千円	取締役(社外取締役を除く)	4名	:	52,448千円
		社外取締役	2名	:	3,000千円
監査役報酬の総額	19,759千円	監査役(社外監査役を除く)	0名	:	0千円
		社外監査役	5名	:	19,759千円

(注)上記のほか、役員退職慰労引当金の繰入額は、14,672千円(取締役13,292千円(うち社外取締役 0千円)、監査役1,380千円(うち社外監査役1,380千円))となります。

ロ. 役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役に関しては、取締役会決議により、株主総会で決議された取締役報酬総額の枠内で、常勤・非常勤の別及び役職別の基本報酬の基準(金額レンジ)を設定し、個人別金額の決定は、当該基準の範囲において役員報酬諮問委員会への諮問を条件として社長に一任することとしております。

監査役に関しては、株主総会で決議された監査役報酬総額の枠内で、監査役の協議により決定されております。

⑤ 株式の保有状況

該当事項はありません。

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とすることを定款で定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

⑧ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

⑨ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は法令に定める額のいずれか高い額としております。

⑩ 株主総会の特別決議要件の変更

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和させることにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 中間配当

当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。

⑫ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
提出会社	46,000	3,416	44,000	—
連結子会社	7,000	—	6,700	—
計	53,000	3,416	50,700	—

② 【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の連結子会社は、当社の監査法人と同じアーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームである監査法人に対して、監査報酬及びその他の報酬として約3,228千円支払っております。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社は、当社の監査法人と同じアーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームである監査法人に対して、監査報酬及びその他の報酬として約3,519千円支払っております。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務です。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、事業の規模・特性等を勘案した監査公認会計士等の見積もりに基づき、精査を行い、監査役会の同意を得て決定しております。

## 第5【経理の状況】

### 1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

### 3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

また、公益財団法人財務会計基準機構及び監査法人等の主催する研修に参加しております。

































































































































